

漢民科技於 SEMICON Taiwan 2026 展出半導體關鍵設備與量子技術

2026 年 8 月 5 日 – 台灣新竹 – 漢民科技將攜手漢辰科技、漢民測試系統及多家合作夥伴，於 2026 年 9 月 2 日至 4 日參展 SEMICON Taiwan 2026，於台北南港展覽館一館 4 樓 M0634 與 M0538 攤位展出，展示涵蓋關鍵半導體製程設備、化合物半導體材料、半導體測試解決方案，以及光量子關鍵元件與製程技術。

本次展出重點包括低能量高電流離子植入機 (Ion Implanter)、感應耦合電漿蝕刻機 (ICP Etcher)、金屬有機化學氣相沉積系統 (MOCVD) 等自主研發設備，以及 8 吋與 12 吋碳化矽基板 (SiC Wafer)，展現漢民科技在先進半導體製程與化合物半導體領域的技術成果。



因應量子科技發展趨勢，漢民科技近年積極投入超導薄膜磊晶與量子元件製程技術研發，建立超導薄膜磊晶成長技術平台，並持續發展光量子元件 – 超導奈米線單光子偵測器系統 (SNSPD) 及光量子晶片 (Quantum Photonic IC) 的研究與開發。本次展會亦將於量子專區展示相關技術成果，呈現漢民科技於量子運算與量子通訊領域的布局。

誠摯邀請業界先進蒞臨 SEMICON Taiwan 2026，參觀漢民科技展位 (M0634 / M0538)，共同交流先進半導體與量子技術的創新應用與未來發展。

關於漢民科技

漢民科技成立於 1977 年，我們以半導體設備代理為起點，朝自主設備研發與前瞻科技邁步向前，提供客戶一流的產品與服務。近半世紀以來，漢民服務多家半導體設備大廠，並成功開發 ICP 電漿蝕刻機 (ICP Etcher)、離子植入機 (Ion Beam Implanter) 與有機化學氣相沉積 (MOCVD) 等設備，深耕於化合物半導體材料 — 碳化矽基板 (SiC Wafer)，並提供高品質超導體、半導體磊晶薄膜 (Superconductor, Semiconductor Epitaxial Thin Films)，以及量子元件代工 (Quantum Device Foundry)。漢民的服務據點遍及台灣、美國、日本、新加坡、馬來西亞與中國大陸，員工總數超過 1200 人。更多資訊，請瀏覽官網：

<https://www.hermes.com.tw/>。

新聞聯絡人

Janice Liao 廖巧矜

電話：03-579-7711 ext. 6359

Email：Janice.Liao@hermes.com.tw